Factsheet

Neue Halbleiter-Fertigung von Bosch in Dresden

19. Juni 2017
PI 9705 AE joe/af

Allgemeine Informationen

▶ Investitionssumme	rund 1 Milliarde Euro
▶ Baubeginn	voraussichtlich Ende 2017 / Anfang 2018
▶ Fertigstellung	bis Ende 2019, die Produktion soll voraussichtlich Ende 2021 starten
▶ Grundstück	zirka 60 000 m^2
▶ Gebäude	ein Gebäude mit bis zu 15 000 m^2 Fertigungsfläche und separaten Büroflächen
▶ Mitarbeiter am Standort	bis zu 700 (geplant)

Informationen zur Halbleiter-Fertigung bei Bosch

▶ Aktuelles Portfolio	Beschleunigungs-, Drehraten-, Massenfluss-, Druck- und Umweltsensoren sowie Mikrofone, Leistungshalbleiter und anwendungsspezifische Schaltungen (ASICs) für Fahrzeugsteuergeräte

Robert Bosch GmbH
Postfach 10 60 50
D-70049 Stuttgart

E-Mail joern.ebberg@de.bosch.com
Telefon +49 711 811-26223
Telefax +49 711 811-5187718

Corporate Communications,
Brand Management, and Sustainability
Leitung: Dr. Christoph Zemelka
www.bosch-presse.de

▶ Fertigungsstandorte	Reutlingen, Baden-Württemberg (150-mm- und 200-mm-Technologie)
▶ Produktion	aus Reutlingen liefert Bosch täglich rund 4 Millionen MEMS und rund 1,5 Millionen ASICs
▶ Patente	Bosch hält mehr als 1.000 Patente und Patentanmeldungen im Bereich der MEMS-Technologie
▶ Auszeichnung	Deutscher Zukunftspreis 2008 für den Durchbruch in der „Oberflächen-Mikromechanik“
▶ Historie	Seit mehr als 45 Jahren entwickelt und fertigt Bosch mikroelektronische Bauteile und Systeme; Bosch hat vor 20 Jahren den Halbleiter-Fertigungsprozess für mikroelektromechanische Systeme (MEMS) entwickelt und ist heute Weltmarktführer

Bosch in Deutschland

▶ Stammsitz	Gerlingen-Schillerhöhe bei Stuttgart, Baden-Württemberg
▶ Umsatz	2016: 14,5 Milliarden Euro (weltweit 73,1 Milliarden Euro)
▶ Mitarbeiter	rund 134 000 Mitarbeiter, davon rund 26 800 Forscher und Entwickler; weltweit rund 390 000 Mitarbeiter (Stand 31.12.2016)
▶ Standorte	70, davon 39 FuE-Standorte (Stand 31.12.2016)